



2025年 台灣矽科宏晟科技股份有限公司 法人說明會

股票代碼：**6725**

免責聲明

1

本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部份將超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。

2

所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。

3

本公司並不保證資料之正確性，且不負有更新及修正本簡報資料內容之責任。

報告人

副總經理

-陳明賢-



董事長

-郭錦松-



總經理

-柯燦塗-



CONTENTS

01

公司簡介

About CICA-HUNTEK Chemical Technology Taiwan Ltd.

02

產品發展概述

Product Development Overview

03

營運狀況

Operational Status

04

競爭優勢

Competitive Advantage

05

營運展望

Operational Outlook

06

企業責任

Corporate Responsibility

公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任

公司基本資料

董事長

郭錦松

總經理

柯燦塗

總公司

新竹,臺灣

資本額

NTD 330,000,000

員工數

397名

股東結構

宏晟科技20年自動化監控系統設計規劃

關東化學(日本)：40年化學供應設備設計開發經驗

主要成果

本公司成立以來，在半導體、晶圓代工、液晶平板顯示器、太陽能電池等電子工業領域皆有顯著的成績。在世界各地已陸續安裝超過 3,000 套以上的系統工程實績。並從設計、組配、安裝、施工到維修皆有一貫的服務標準，因此深獲許多客戶的高度評價。



您最信賴，最專業，最敬業的合作夥伴。

公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任

公司簡介



台南服務據點

台南市善化區陽光
南一路2巷56號



台中服務據點

台中市西屯區漢口
路二段138號4F



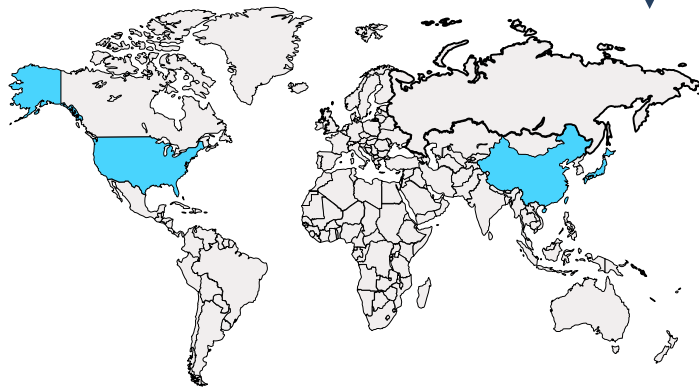
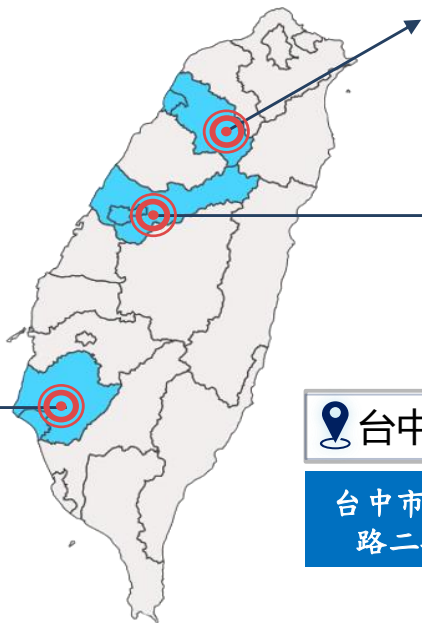
新竹總公司

新竹縣竹北市縣政
九路145號8樓-1



海外據點

- ◆ 上海
- ◆ 廣州
- ◆ 美國
- ◆ 日本
- ◆ 新加坡



公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

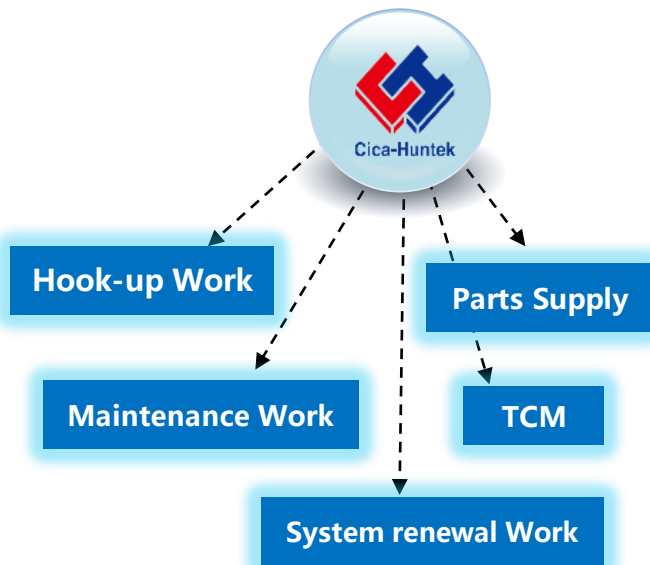
營運展望

企業責任

主要產品介紹

Chemical Dispense System

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Chemical dispense system(Fresh) |
| 2 | Chemical mixing system |
| 3 | Chemical dilution system |
| 4 | Waste collection system |
| 5 | Chemical recycling system(ESG) |



公司簡介

產品發展概述

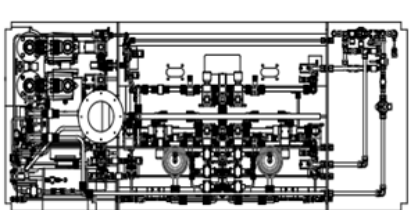
營運狀況

競爭優勢

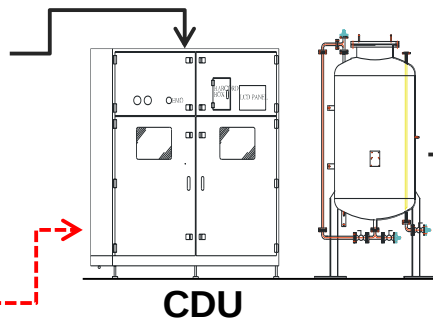
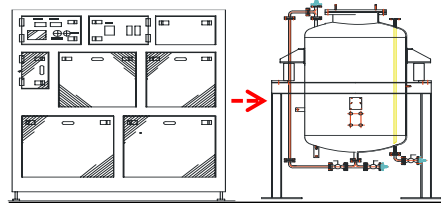
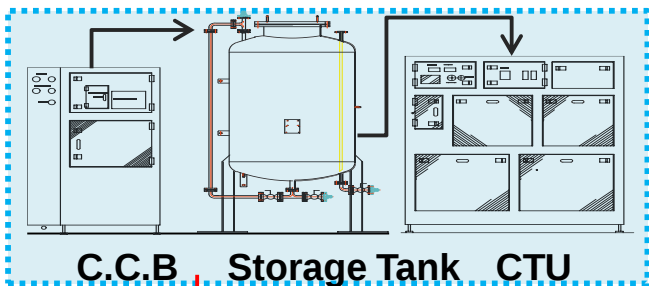
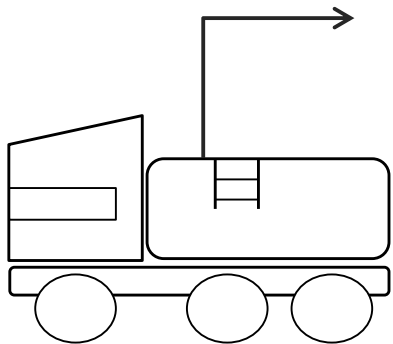
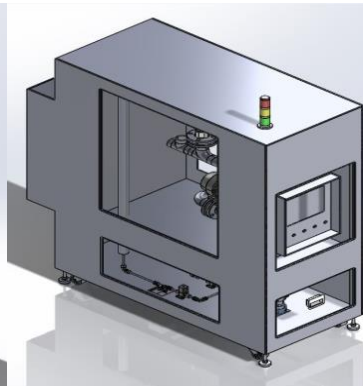
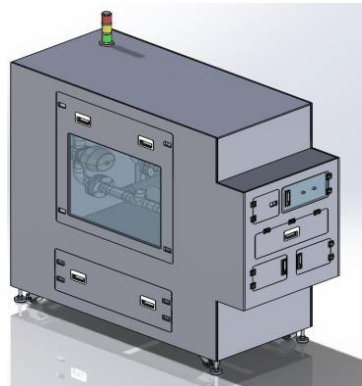
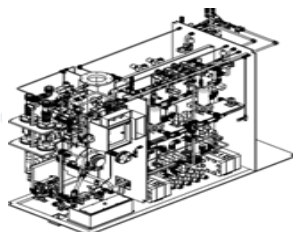
營運展望

企業責任

產品服務概述



top side view



公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

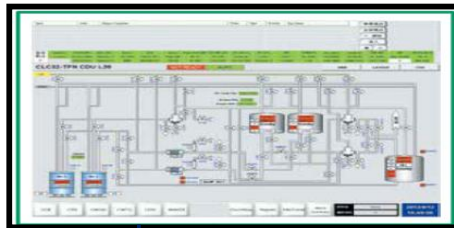
營運展望

企業責任

系統整合能力



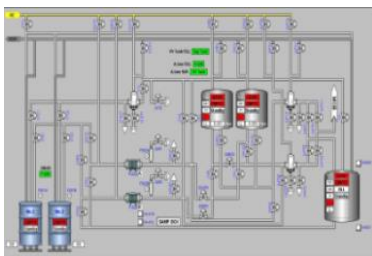
Master Control Panel



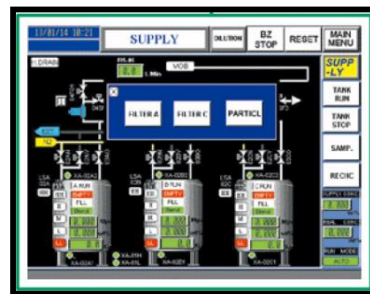
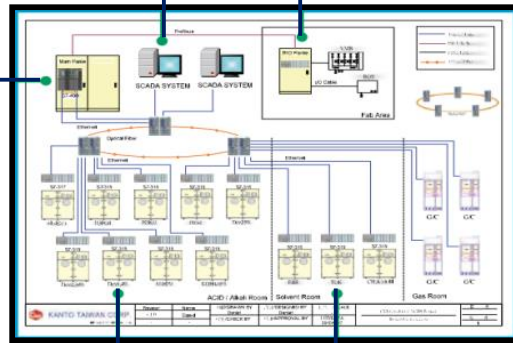
SCADA
And Monitoring



Field Control Panel



Equipment



HMI

您最信賴，最專業，最敬業的合作夥伴。

公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

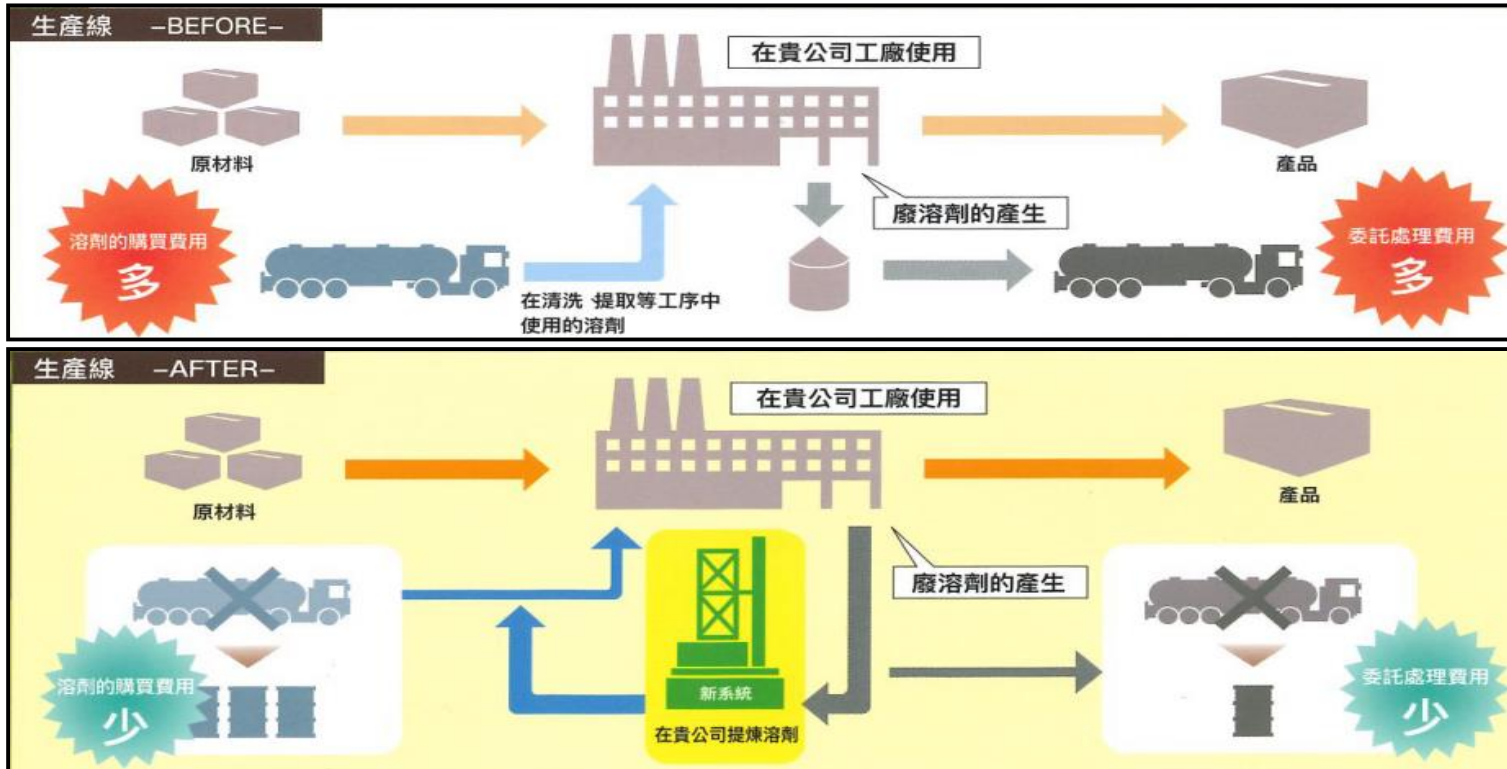
營運展望

企業責任

◆ 系統特色

藉由化學品再生回收設備系統將製造半導體、FPD(Flat Panel Display)、太陽電池等中用過的化學品(廢液)以回收、蒸餾、過濾、添加化學品方式進行再生，並再利用於製程中。

多樣發展-廢液處理及再回收



公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任

多樣發展 - Tank 檢測及熱影像法

外觀目測檢視

確認是否有漏液
外表腐食或髒污等情況

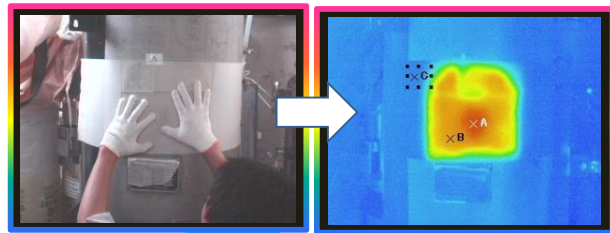
絕緣阻抗測定

探測Lining是否有
藥液滲透或針孔

熱影像技術/耐震檢查

探測Lining材的剝離、浮出及大小

Lining
Tank



測量紅外線放射熱能**影像化**。
解析得到的熱影像經時間變化觀察**剝離(凸起)**。

Lining材剝離處進行強制加熱時，
剝離處的**溫度**較健全處不易**下降**。

◆ 系統特色

- 設備檢測優點:
生產線不停止,設備運轉中仍可進行檢測。
- 可早期發現內部異常:
使用各種檢查機器確認部品內部的劣化及異常。
- 瞭解適當的更換時間:
由定期檢測而累積的Data。
出現劣化傾向時可設定適當的更換時間。

公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任



專注新產品開發 - 自動取樣機

產品功能

- 1 自動化取樣** 可以按照預設的時間間隔或條件自動地收集樣品，並將存儲在取樣瓶中。
- 2 訂取樣模式** 具有手動取樣和自動取樣模式及可自訂的參數值，能夠根據需要進行調整。
- 3 精準控制** 通過精確的控制系統，確保取樣的準確性和一致性，從而避免取樣過程中的誤差。
- 4 隨時取樣** 體積精巧、隨時可以移動設備，能夠完美解決您在實驗室和生產線上進行樣品取樣的煩惱。
- 5 監測報警** 自動取樣機可以根據預設的條件對樣品進行監測和分析，如果出現異常狀況，可以發出報警信號，提醒使用者進行相關處理。



公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任



專注新產品開發-抗鏽夾具

新型名稱	避免化學腐蝕的塑膠夾具	新型所屬技術領域	避免化學腐蝕的塑膠夾具
專利類	TW 111206894	專利類	202221679471.6
摘要	一種避免化學腐蝕的塑膠夾具，該塑膠夾具用以固定一閥件，該塑膠夾具包含一承座，一上夾板及二組裝架，該承座包含一下夾板及二連接該下夾板兩端並相對該下夾板為彎折的支撐腿，該二組裝架組裝於上夾板的兩相對側並位於該下夾板的兩相對位置上，該二組裝架的每一具有一提供該閥件穿出的鏤空區域，該二組裝架與該上夾板、該承座之間以樺接方式固定，並共同界定出一閥安裝空間，承此本新型改善習用夾具容易受化學品影響而造成腐蝕生鏽的缺點，同時具備有方便拆裝的特性。		

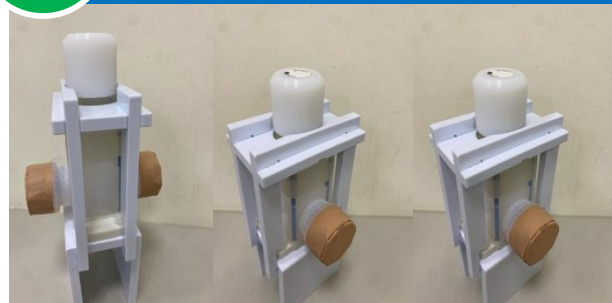
A

改善機台原閥件夾具造成之生鏽腐蝕之狀況，採用工程塑膠的材質並不會造成生鏽腐蝕而造成的影響。



B

固定方式也從螺絲改為卡樺結構方便拆裝也加強牢固。



公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任

全球佈局-營運據點

 海外據點

- ◆ 上海
- ◆ 廣州
- ◆ 美國
- ◆ 日本
- ◆ 新加坡

 新竹總公司

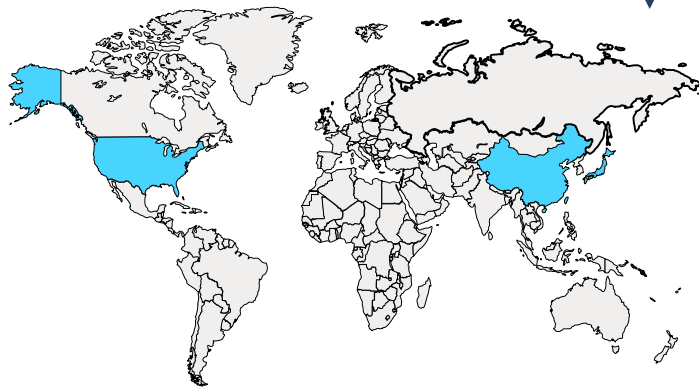
新竹縣竹北市縣政
九路145號8樓-1

 台中服務據點

台中市西屯區漢口
路二段138號4F

 台南服務據點

台南市善化區陽光
南一路2巷56號



公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任

全球佈局

IC高階制程 5、7、10nm

- TSMC 12P6 N5/N28/N20
- TSMC 15P5 N10
- TSMC 15P6 N7/N10
- TSMC 18P1、P2、P3 N5
- HLMC FAB1 (N45.N55) SH
- SMNC FAB 2A (N28) BJ

TFT 4K2K最新制程設備

- AUO-6A/G6.5 CU
- AUO-8B/G8.5 GED-1
- AUO-8B/G8.5 GED-2
- SDP-廣州 G10

AP-先進封裝

- TSMC AP5B Project
- TSMC AP7A Project
- TSMC AP8A Project

台灣



中國



日本



泰國



越南



新加坡



菲律賓



公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任

先進製程實績

處理器A15晶片，5奈米製程。

F18P3 Chemical package
(承接199台 - CDS)

處理器A15晶片，5奈米製程。

F18P1 Chemical package
(承接196台 - CDS+WCCS)

蘋果A11 Bionic晶片採
10奈米 Fin FET 製程生產。

F15P5 Chemical package
(承接126台 - CDS)

iPhone
13系列

2020

iPhone
13系列

2018

iPhone
x

2015

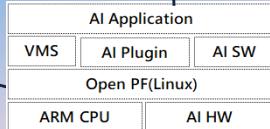
2024

AI 伺服器



Advance Package

AI Server



客戶
雲端

2019

iPhone
13系列

處理器A15晶片，5奈米製程。

F18P2 Chemical package
(承接193台 - CDS)

2016

iPhone XS、
XS Max、
iPhone XR

A12 Bionic 晶片，號稱全球
首款7奈米晶片的智慧型手機。

F15P6 Chemical package
(承接126台 - CDS)



Cica-Huntek



圖片來源/聯合新聞網及美港聯和

公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任

財務資訊

單位:台幣 仟元

項目	2021年	2022年	2023年	2024年
營業收入	943,508	1,192,086	2,807,803	3,153,687
營業毛利	180,899	230,458	802,125	972,761
毛利率	19%	19%	28%	31%
營業利益率	11%	10%	22%	24%
本期淨利	90,368	110,978	516,172	616,277
稅後淨利率	10%	9%	18%	20%
每股盈餘(元)	2.84	3.36	15.64	18.68



公司簡介

產品發展概述

營運狀況

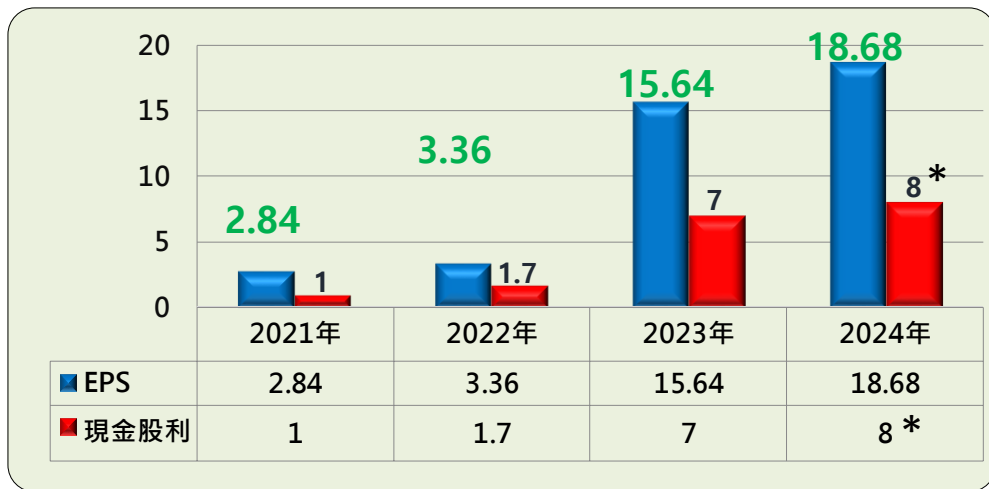
競爭優勢

營運展望

企業責任

財務資訊

歷年EPS與股利



* 2025/3/25經董事會擬發放8元，最終實際發放額由股東會2025/6/25 確認

公司簡介

產品發展概述

營運狀況

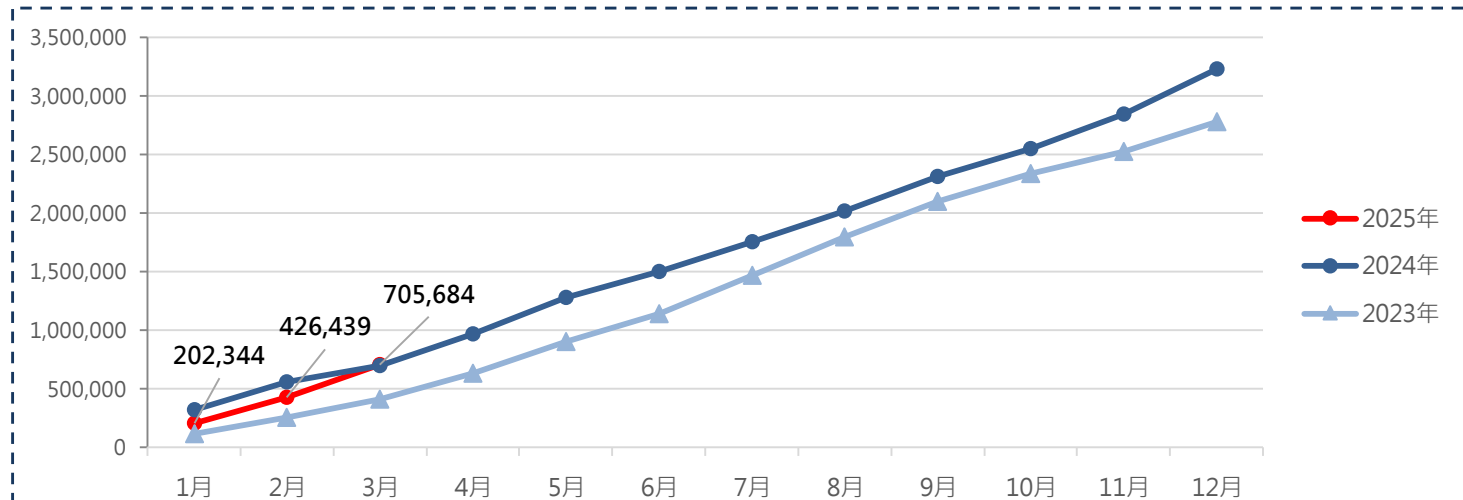
競爭優勢

營運展望

企業責任

財務資訊

單位:台幣 仟元



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計
2025年	202,344	224,095	279,245										705,684
2024年	320,755	235,992	138,878	272,324	310,906	224,123	255,311	260,253	295,583	234,564	298,954	386,895	3,234,538
變動比率%	-36.92%	-5.04%	101.07%										
2023年	115,329	137,766	155,878	227,491	265,168	236,879	330,135	324,978	310,592	231,421	193,772	255,839	2,785,248

您最信賴，最專業，最敬業的合作夥伴。

公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任

競爭優勢

享有先進製程業務版圖的高佔率，同時具N5(IC),IGZO(TFT) 產業設備製造實績。

高階設備製程製造實績，銷售設備台數接近1000套。(N20、N10、N7、N5)。

自有電控軟體技術核心，掌握設備高端效能。(減低運轉風險，避免介面上修改異常)。

展望未來

2024

百人以上TCM團隊，
便於專案執行上人力支援。

客製化設計團隊運用3D製圖能力，
達到最佳空間規劃。

國際觀的設計理念，矽科團隊已耕耘日本、新加坡、泰國及其他海外區域，技術開發及新資訊交流，有效加強專案領域的提昇。



立

足

台

灣

站

穩

亞

洲

放

眼

世

界

公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任

競爭優勢

專利技術(2020年)

輸送化學藥液的送料機構
(新型專利M605810)

專利技術(2021年)

漏液導引的化學藥液分閥箱
(新型專利M618324)



2020

2021

2022

2023

2024

專利技術(2022年)

- 可分拆的法蘭結構 (新型專利M631256)
- 化學品供液接頭 (新型專利M632324)
- 自動取樣機 (新型專利M634295)
- 廢液溢流檢測結構及排廢裝置 (新型專利M635448)
- 承座可擺動的取樣裝置 (新型專利 M635474)
- 避免化學腐蝕的塑膠夾具 (新型專利M635652)
- 化學閥件的整合式組裝結構 (新型專利M636929)

年度

獲獎紀錄

2023年
5月

中華徵信所2023 TOP500中，
【專案生產機業】大型企業排名第45名。

2023年
6月

獲第20屆國家品牌玉山獎 最佳產品類。

年度

獲獎紀錄

2024年
5月

獲天下雜誌2024年《天下》兩千大調查：
■ 營運績效類別排名第**6**名
■ 製造業成長最快公司排名第**8**名。



公司簡介

產品發展概述

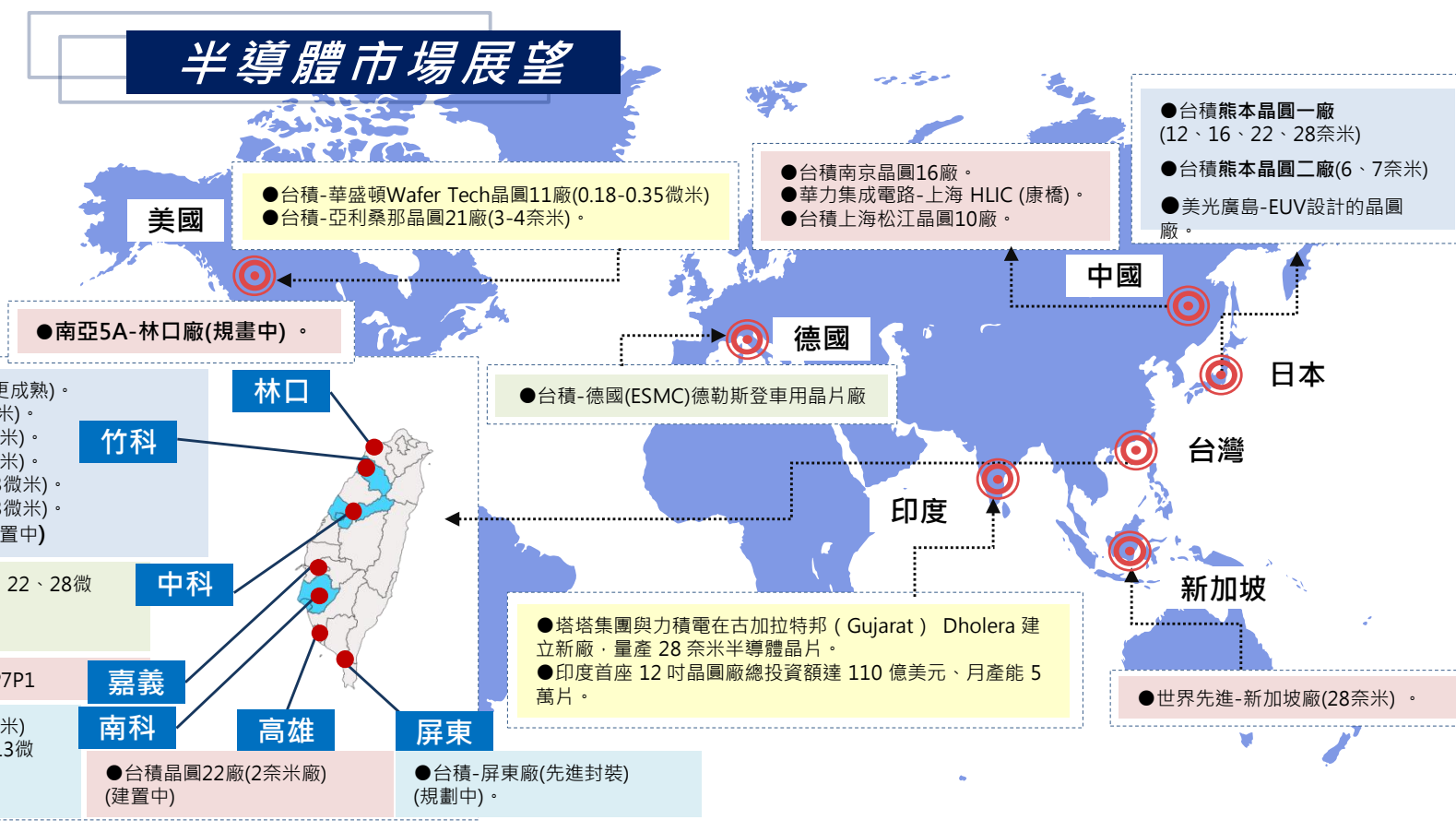
營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任

半導體市場展望



公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任

半導體市場展望

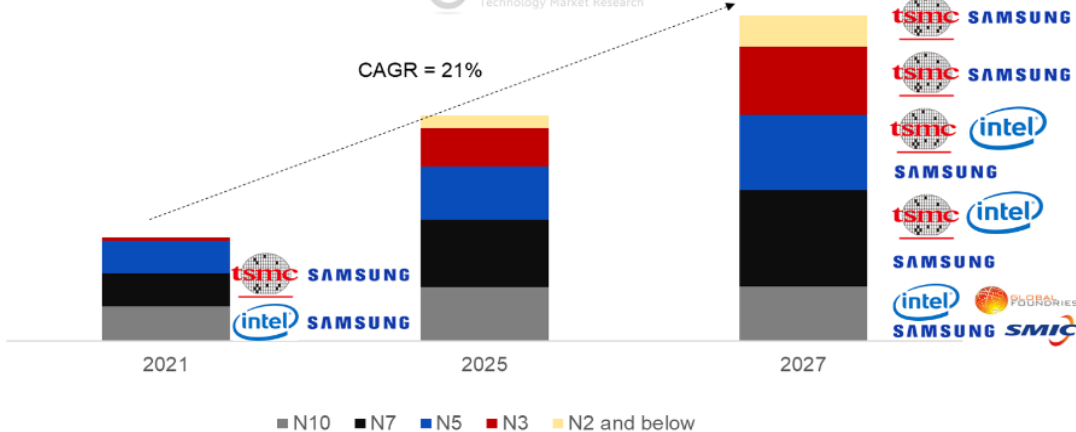
Global logic fab capacity breakdown in leading-edge nodes

(wafer manufacturing at 10nm and below; Foundry and IDM)

Installed capacity (KWPM)

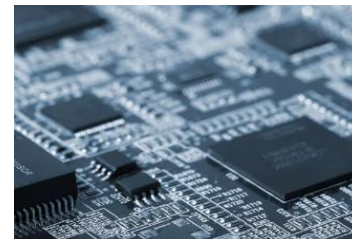
Counterpoint
Technology Market Research

CAGR = 21%



- N10 includes 10nm, 8nm, and N+1/N+2 nodes defined by various foundry/IDM suppliers
- N7 includes 7nm, +7nm and 6nm; N5 includes 5nm and 4nm

資料來源: counterpoint-<https://www.counterpointresearch.com/zh-hans/insights/massive-fab-expansion-to-change-geographical-mix-of-supply/>



圖片來源: SEMI Taiwan網站

公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任

營運展望

矽科宏晟未來成長方向

◆ 成長方向

矽科宏晟過去較著重在CDS產品上的發展，並專注服務先進製程的龍頭客戶，後續將從：
「**新客戶、新產業**」、「**新增服務類別**」、「**深化地理區域**」三個面向進行成長發展。

擴大滲透率

- 對於既有客戶、產品，增加產業 (CIS、PCB)。
- 由CDS為主，跨入SDS/Bump。
- AP先進封裝**CoWoS**，跨入AI。

增加產品

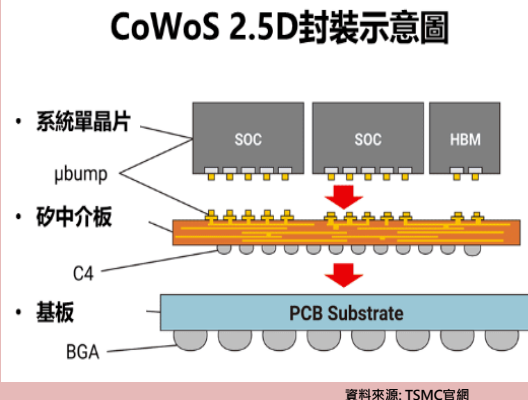
- 桶槽檢測。
- 分散主要客戶的集中度。
- 發展化學品回收及再利用系統。

跨大客戶基礎

- 新增海外客戶(日本、德國、印度..等)
- 分散主要客戶的集中度。
- 遵循國際規則及法規，經營中國市場及國內主要擴廠擴線客戶。

擴展新地理區域

- 2018年中國設立子公司。
- 2021年美國設立子公司。
- 2023年日本設立子公司。
- 2024年新加坡設立子公司。



先進封裝市場持續強勁成長

根據Yole Développement的最新調查報告，全球先進封裝市場在2019年至2025年之間的複合年成長率(CAGR)為6.6%，預計將帶動市場營收在此期間增加一倍以上。Yole先進封裝團隊預測，到2025年該市場營收將突破420億美元。這幾乎是傳統封裝市場預期成長率(2.2%)的3倍。

公司簡介

產品發展概述

營運狀況

競爭優勢

營運展望

企業責任

企業責任

公司治理

- ◆ 成立永續發展委員會
- ◆ 制定永續發展實務守則
- ◆ 承諾出具2024年度永續報告書

環境

- ◆ 提倡節電政策
- ◆ 宣導減碳行動
- ◆ 啟動廢棄物管理機制

社會

- ◆ 多元、公平與共融宣言
- ◆ 員工健康管理及講座
- ◆ 響應地方捐血活動





您最信賴，最專業，最敬業的合作夥伴！！

股票代碼：6725

THANKS FOR YOUR WATCHING